

日清エンジニアリング 「TOKYO PACK 2022 - 2022 東京国際包装展 -」に出展 ～工場・生産設備のエンジニアリング力をアピール～

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社（取締役社長：村田 博）は、本年10月12日（水）～10月14日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「TOKYO PACK 2022 - 2022 東京国際包装展 -」に出展します。

■ 当社出展内容（ブース番号：東ホール 1-77）

当社ブースでは、食品や粉体等を取り扱う工場・生産設備のトータルエンジニアリングを提案します。特に、粉体ハンドリング技術として、少量多品種生産に適したバッチシステムである「マトコン・コンテナ（IBC）システム」をご紹介します。



<ブースイメージ>

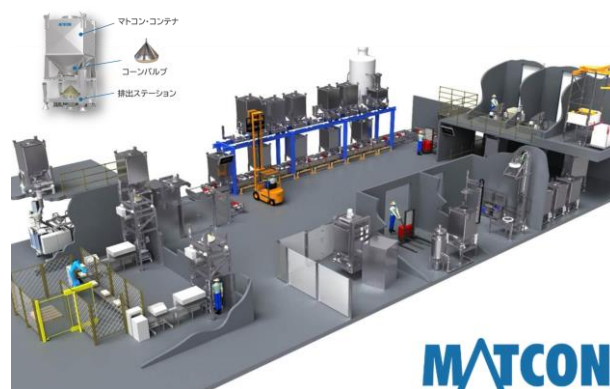
《主な出展内容》

■ マトコン・コンテナ（IBC）システム

IBC（中間バルクコンテナ）を用いた少量多品種生産に適したバッチシステムです。

当社が2002年から英国マトコン社のエンジニアリング・パートナーとしてお客様へ導入させていただいており、これまで食品・医薬のみならず、化学、金属粉体や電子・電池材料粉体など、幅広い分野で採用されています。

コンタミネーションのリスクを低減し、少量多品種生産を効率化するコンテナシステムをご紹介します。



<マトコン・コンテナ（IBC）システム>

■ 食品・粉体工場トータルエンジニアリング

工場建設や生産設備施工のプロジェクトについて、トータルエンジニアリングの視点から、進め方・取り組み方のポイントをご紹介します。また当社の豊富な実績の一部を展示します。

■「TOKYO PACK 2022 — 2022 東京国際包装展 —」概要

TOKYO PACK（トウキョウパック）は、包装資材、包装機械から包材加工機械、食品機械、関連機器類、環境対応機材、物流機器類に至る生産・包装・流通の技術振興をはかるとともに、商談や交流および包装の最新情報発信の場として、国際的な視野に立った社会の発展に資することを目的とした、世界有数の国際総合包装展です。

- 日 時：2022年10月12日（水）～10月14日（金）10：00～17：00
- 会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
東展示棟（1～3・6ホール）
- 主 催：公益社団法人日本包装技術協会（Japan Packaging Institute）
- 開催テーマ：新時代パッケージ ここに集う！—未来のために機能進化と使命—
- 公式Webサイト：<https://www.tokyo-pack.jp/>

以上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先
株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：神田・^{ひらき}開・徳田
電話：03-5282-6650（お問い合わせフォームは[こちら](#)）